

第4期

運用報告書(全体版)

アジア半導体関連フォーカスファンド
(愛称 ライジング・セミコン・アジア)

【2026年7月17日決算】

受益者の皆様へ

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

皆様の「アジア半導体関連フォーカスファンド(愛称 ライジング・セミコン・アジア)」は、2026年7月17日に第4期決算を迎えましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1
ホームページ <https://www.sbiokasan-am.co.jp>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
03-3516-1300 (受付時間：営業日の9:00～17:00)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	2024年7月17日から2045年7月14日までです。	
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業*の株式(これに準ずるものを含みます。)に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 ※アジア半導体関連企業とは、半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業をいいます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要投資対象	当ファンド	Next Generation Semiconductor Asia Fund (円建て、ヘッジなしクラス)の受益証券およびマネー・リクイディティ・マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	Next Generation Semiconductor Asia Fund (円建て、ヘッジなしクラス)	日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業の株式(預託証券(DR)を含みます。)を主要投資対象とします。
	マネー・リクイディティ・マザーファンド	わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。	
分配方針	年2回、1月および7月の各月の17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。 分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。 分配金額は、分配対象収益の範囲内で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。 委託会社の判断により、収益分配を行わないことがあります。	

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		MSCI オール・カンントリー・アジア・インデックス (米ドル建て、配当込み) [円換算後]		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 証 組 入 比	純 資 産 額
		税 分	達 配 金	期 騰 落	中 率				
(設定日)	円	円	円	騰 落	中 率	組 入 比	券 率	証 組 入 比	純 資 産 額
2024年7月17日	10,000	—	—	51,284.49	—	—	—	—	14,732
1期(2025年1月17日)	9,071	0	△ 9.3	48,587.20	△ 5.3	0.2	97.5	26,934	
2期(2025年7月17日)	9,189	0	1.3	53,768.94	10.7	0.1	98.0	26,356	
3期(2026年1月19日)	15,156	0	64.9	69,321.68	28.9	0.1	98.1	21,858	
4期(2026年7月17日)	27,758	0	83.1	81,001.65	16.8	0.1	99.1	39,434	

(注) 基準価額および分配金（税引前）は1万口当たり、基準価額の騰落率は分配金（税引前）込み。

(注) 設定日の基準価額および純資産総額は当初設定元本。

(注) MSCI オール・カンントリー・アジア・インデックス（米ドル建て、配当込み）[円換算後]は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。MSCI オール・カンントリー・アジア・インデックス（米ドル建て、配当込み）[円換算後]は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて当社が算出しております。（以下同じ。）

(注) 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、債券組入比率は実質比率を記載しております。

MSCI指数はMSCI Inc. が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。またMSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

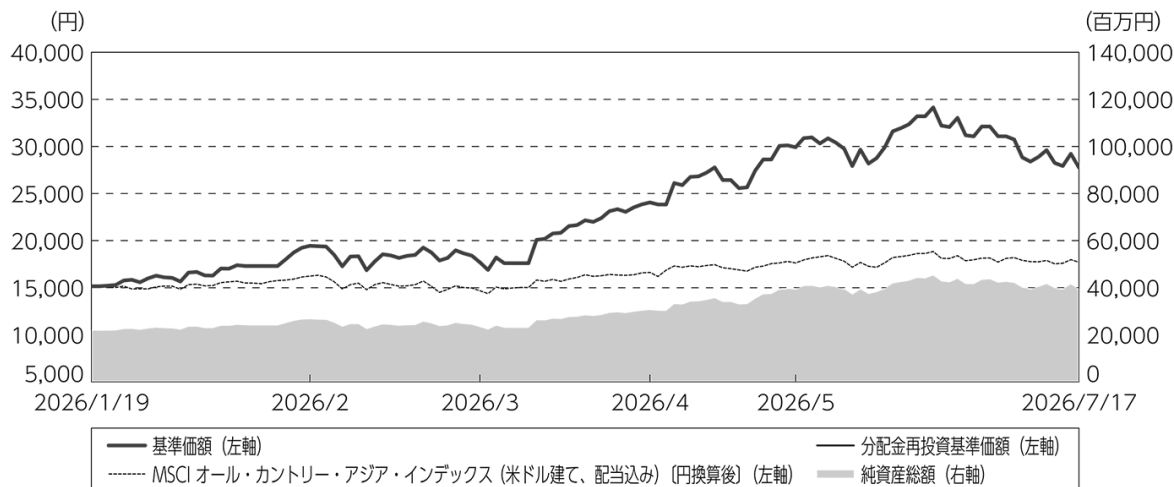
年	月	日	基 準	価 額		MSCI オール・カンントリー・アジア・インデックス (米ドル建て、配当込み) [円換算後]		債 組 入 比	券 率	投 資 信 託 証 組 入 比	率
				騰 落	率	(参考指数)	騰 落 率				
	(期 首)		円	%	ポイント	%	%	%			
	2026年 1 月19日		15, 156	—	69, 321. 68	—	0. 1	98. 1			
	1 月末		16, 104	6. 3	69, 412. 99	0. 1	0. 1	97. 8			
	2 月末		19, 451	28. 3	74, 262. 32	7. 1	0. 1	98. 1			
	3 月末		17, 694	16. 7	67, 140. 65	△ 3. 1	0. 1	98. 2			
	4 月末		24, 056	58. 7	76, 063. 19	9. 7	0. 1	98. 9			
	5 月末		29, 917	97. 4	80, 632. 69	16. 3	0. 1	99. 1			
	6 月末		31, 071	105. 0	82, 190. 45	18. 6	0. 1	99. 0			
	(期 末)										
	2026年 7 月17日		27, 758	83. 1	81, 001. 65	16. 8	0. 1	99. 1			

(注) 騰落率は期首比。

運用経過

期中の基準価額等の推移

（2026年1月20日～2026年7月17日）



期 首：15,156円

期 末：27,758円（既払分配金（税引前）：0円）

騰落率： 83.1%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、MSCI オール・カントリー・アジア・インデックス（米ドル建て、配当込み）〔円換算後〕です。
- (注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2026年1月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

〇基準価額の主な変動要因

当ファンドの主要投資対象である「Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）」における主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

- 個別銘柄では、業績が好調な韓国の半導体メーカーSK HYNIXや韓国の電子部品メーカーSAMSUNG ELECTRO-MECHANICS、日本の半導体メモリ製品メーカー、キオクシアホールディングスなどの株価上昇がプラスに寄与しました。

（主なマイナス要因）

- 個別銘柄では、業績が振るわなかったオーストラリアの特殊化学品メーカーALPHA HPAや韓国の原材料メーカーCMTX、韓国のプリント基板メーカーISUPETASYSなどの株価下落がマイナスに影響しました。

投資環境

（2026年1月20日～2026年7月17日）

アジア株式市場は上昇しました。米国・イスラエルとイランの軍事衝突の発生を受けて株式市場の変動性が高まりましたが、大手IT企業が人工知能（AI）インフラ向けの積極的な設備投資を続けたことを追い風に、半導体関連銘柄が株式市場の上昇を牽引しました。米国とイランは戦闘終結に係る覚書で合意にこぎつけたものの、協議は難航しました。その間、原油価格は高水準で推移し、世界の経済・物価動向に対する悪影響が懸念されました。一方、AI開発を手掛ける米アンソロビックが専門業務の自動化を目的とした新ツールを発表するなど、AI開発には一段の進展が見られました。また、韓国の半導体メモリ大手であるSKハイニックスが米国市場において米国預託証券（ADR）を上場し、米国外の企業として過去最大規模の新規上場となりました。こうした中、アジアの半導体関連銘柄は良好な業績動向を背景として、株価が大きく上昇しました。

国内短期金融市場では、2026年1月に高市首相が衆議院を解散し財政規律の緩みが意識されたほか、2月末以降、米国とイラン間の軍事衝突を背景とした原油価格の急騰を受け、国内のインフレが加速するとの見方が強まったことなどから、1年国債利回りは上昇しました。7月上旬には骨太の方針を巡る財政拡張への懸念に加え、日銀のインフレへの政策対応が後手に回るとの見方が強まり、利回りは上昇幅を拡大しました。

当ファンドのポートフォリオ

（2026年1月20日～2026年7月17日）

<アジア半導体関連フォーカスファンド（愛称 ライジング・セミコン・アジア）>

「Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）」、「マネー・リクイディティ・マザーファンド」を主要投資対象とし、「Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）」を高位に組み入れて運用を行いました。

実質組入外貨建資産につきましては、運用の基本方針に則り、為替ヘッジは行いませんでした。

○Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業の株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。当期は、半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受けるアジアの半導体関連銘柄に積極的な投資を実施しました。ポートフォリオでは引き続き、AI関連銘柄など長期的な成長が期待できる銘柄などへの投資を行いました。国別では、台湾、日本、韓国に多く配分した運用を行いました。

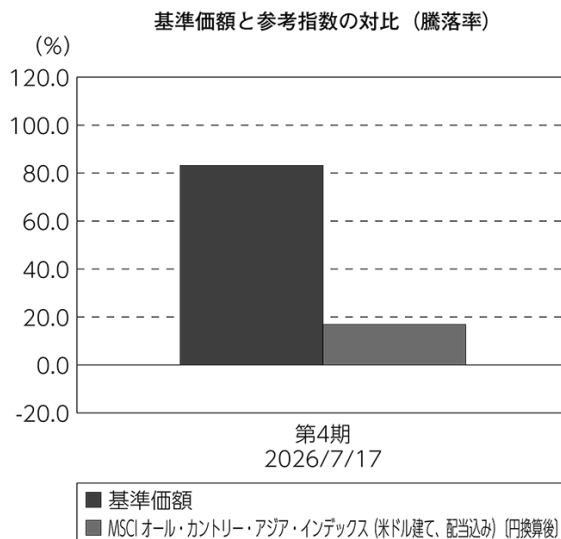
○マネー・リクイディティ・マザーファンド

わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とした運用を行いました。当期間中は、国債のみを組み入れました。

当ファンドのベンチマークとの差異

（2026年1月20日～2026年7月17日）

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

（注）参考指数は、MSCI オール・カンントリー・アジア・インデックス（米ドル建て、配当込み）[円換算後] です。

分配金

（2026年1月20日～2026年7月17日）

当期の分配金につきましては、分配方針に則り、基準価額水準等を勘案して、以下のとおりといたしました。なお、収益分配に充てなかった留保益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行ってまいります。

（単位：円、1万口当たり・税引前）

項 目	第 4 期
	2026年 1 月 20 日～ 2026年 7 月 17 日
当期分配金	—
（対基準価額比率）	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	17,758

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

（投資環境の見通し）

2026年も上半期が終わり、振り返ると金融市場にとって最大のイベントは米国・イスラエルとイランの軍事衝突であったことは明白であるといえます。原油価格が急上昇したことで世界経済の悪化懸念が強まり、実際に我々の生活においてもナフサ不足やジェット燃料不足による航空路線の減便といった影響が顕在化しました。株式市場では、相対的に原油急騰の影響を受けづらく、AI普及拡大の恩恵を受けるハイテク関連銘柄が資金を集め、上昇を牽引する展開となりました。株式市場においては、足元において出遅れていた銘柄を見直す動きが活発化しており、個別銘柄の変動性が高まる状況となっています。また、11月には米国で中間選挙を控え、イラン戦争を経て支持率を落とした共和党が苦戦する展開が予想されています。このように政治・経済両面で見通しが立てづらい状況下、これまで急ピッチで上昇してきた株式市場の変動性が高まる可能性があると考えています。

国内短期金融市場は、日銀による追加利上げ観測が残ることから、1年国債利回りに上昇圧力が掛かる展開を想定しています。

＜アジア半導体関連フォーカスファンド（愛称 ライジング・セミコン・アジア）＞

「Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）」を高位に組み入れて運用を行います。実質組入外貨建資産につきましては、運用の基本方針に則り、為替ヘッジは行わない方針です。

○Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）

今後は、着実な業績成長を達成できる企業の「質」が株価の優勝劣敗を左右すると考えます。社会生活や産業活動のあらゆる場面で進展するデジタル化を支える半導体産業において、アジアはその製造・組立において重要な役割を担っており、魅力的な投資機会が豊富に存在すると考えています。引き続き、徹底したボトムアップ・リサーチを通じて、半導体産業の拡大に伴い業績成長が期待できるアジア企業を選定し、パリュエーションにも注意を払った運用を実施して参ります。

○マネー・リクイディティ・マザーファンド

わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益確保を目的に運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2026年 1 月20日～2026年 7 月17日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 146	% 0.634	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	（ 44 ）	（0.189）	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	（ 99 ）	（0.432）	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	（ 3 ）	（0.013）	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.006	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	（ 1 ）	（0.006）	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	147	0.640	
期中の平均基準価額は、23,048円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

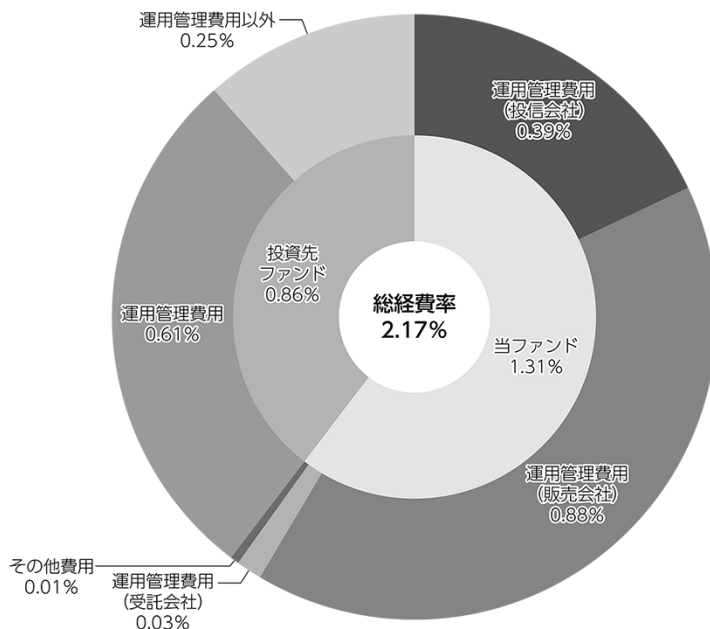
（注）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.17%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	2.17
①当ファンドの費用の比率	1.31
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.61
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.25

(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2026年 1月20日～2026年 7月17日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国内	Next Generation Semiconductor Asia Fund (円建て、ヘッジなしクラス)	口 247,993	千円 6,080,000	口 283,921	千円 4,815,000

(注) 金額は受渡代金。

(注) 単位未満は切捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄		設 定		解 約	
		口 数	金 額	口 数	金 額
マネー・リクイディティ・マザーファンド		千口 35,195	千円 35,400	千口 —	千円 —

(注) 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2026年 1月20日～2026年 7月17日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2026年 7月17日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
Next Generation Semiconductor Asia Fund (円建て、ヘッジなしクラス)		口 1,537,028	口 1,501,100	千円 39,061,633	% 99.1
合 計		1,537,028	1,501,100	39,061,633	99.1

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
マネー・リクイディティ・マザーファンド	千口	千口	千円
	23,531	58,727	59,185

(注) 口数・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年7月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円	%
	39,061,633	97.5
マネー・リクイディティ・マザーファンド	59,185	0.1
コール・ローン等、その他	952,972	2.4
投資信託財産総額	40,073,790	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年7月17日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	40,073,790,577
コール・ローン等	952,948,385
投資信託受益証券(評価額)	39,061,633,828
マネー・リクイディティ・マザーファンド(評価額)	59,185,702
未収利息	22,662
(B) 負債	638,815,774
未払金	218,000,000
未払解約金	224,299,031
未払信託報酬	194,530,112
その他未払費用	1,986,631
(C) 純資産総額(A－B)	39,434,974,803
元本	14,206,450,351
次期繰越損益金	25,228,524,452
(D) 受益権総口数	14,206,450,351口
1万口当たり基準価額(C／D)	27,758円

(注) 計算期間末における1口当たりの純資産額は、2.7758円です。

(注) 当ファンドの期首元本額は14,422,238,105円、期中追加設定元本額は3,645,849,785円、期中一部解約元本額は3,861,637,539円です。

○損益の状況（2026年1月20日～2026年7月17日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,501,759
受取利息	2,501,759
(B) 有価証券売買損益	13,965,346,780
売買益	16,255,639,065
売買損	△ 2,290,292,285
(C) 信託報酬等	△ 196,516,743
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	13,771,331,796
(E) 前期繰越損益金	6,043,264,398
(F) 追加信託差損益金	5,413,928,258
(配当等相当額)	(1,901,769,435)
(売買損益相当額)	(3,512,158,823)
(G) 計(D＋E＋F)	25,228,524,452
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	25,228,524,452
追加信託差損益金	5,413,928,258
(配当等相当額)	(1,901,773,699)
(売買損益相当額)	(3,512,154,559)
分配準備積立金	19,814,596,194

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 収益分配金

決算期	第4期
(a) 配当等収益(費用控除後)	2,623,077円
(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後)	13,768,708,719円
(c) 信託約款に規定する収益調整金	5,413,928,258円
(d) 信託約款に規定する分配準備積立金	6,043,264,398円
分配対象収益(a＋b＋c＋d)	25,228,524,452円
分配対象収益(1万口当たり)	17,758円
分配金額	0円
分配金額(1万口当たり)	0円

＜お知らせ＞

・一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款の記載変更を行いました。(実施日：2026年4月1日)

＜参考情報＞

Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）

＜当ファンドの仕組みは次の通りです＞

	Next Generation Semiconductor Asia Fund
シェアクラス	円建て、ヘッジなしクラス
ファンドの形態	ケイマン籍円建て外国投資信託
運用会社	ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー
基本方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
投資対象	主として、日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業*の株式（預託証券（DR）を含みます。）に投資します。 ※アジア半導体関連企業とは、半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業をいいます。
投資態度	①投資銘柄は、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で選定します。 ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。 ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限	①デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 ②レバレッジを活用した取引（レンディング、レポ取引を含む）及び売建て（ショート）取引は行いません。
運用報酬	純資産総額×年率0.65%
その他費用	運用資産の管理・保管業務等および監査業務の対価としての事務管理費用、有価証券の売買にかかる費用、臨時で発生する費用、租税等がかかります。

以下は、Next Generation Semiconductor Asia Fund（円建て、ヘッジなしクラス）の監査済報告書の一部を、SBI岡三アセットマネジメントが翻訳したものです。SBI岡三アセットマネジメントは正確性、完全性を保証するものではありません。

損益計算書

自 2024年6月11日 至 2025年6月30日
(単位：米ドル)

収益	
受取配当金（330,360米ドル源泉税控除）	1,642,642
受取利息	221,872
収益合計	1,864,514
費用	
運用報酬	948,452
保管費用	175,324
事務管理報酬	77,395
監査報酬	70,213
受託者費用	15,663
名義書換代理人費用	15,451
その他費用	35,150
費用合計	1,337,648
投資純損益	526,866
実現損益	
投資有価証券	△19,952,157
外貨取引および外貨の先渡契約	△ 356,639
純実現損益	△20,308,796
未実現損益	
投資有価証券	17,140,730
外貨取引	8,123
純未実現損益	17,148,853
純実現損益および純未実現損益	△ 3,159,943
当期純損益	△ 2,633,077

Next Generation Semiconductor Asia Fund

Schedule of Investments

As of June 30, 2025

(Expressed in United States Dollars)

Shares	Security Description	Fair Value
	COMMON STOCKS (97.0%)	
	CHINA (0.9%)	
	COMPUTERS (0.9%)	
1,977,600	Horizon Robotics, Inc. Class B	\$ 1,634,942
	TOTAL CHINA (Cost \$1,690,609)	1,634,942
	JAPAN (39.4%)	
	AUTO PARTS & EQUIPMENT (2.8%)	
159,600	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	3,391,749
73,500	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1,574,709
		4,966,458
	CHEMICALS (1.3%)	
94,100	Resonac Holdings Corp.	2,181,510
	COMMERCIAL SERVICES (2.7%)	
174,000	TOPPAN Holdings, Inc.	4,727,606
	ELECTRONICS (9.4%)	
109,700	Dexerials Corp.	1,695,315
14,000	Hoya Corp.	1,662,536
22,900	Maruwa Co., Ltd.	6,553,274
82,400	Shibaura Mechatronics Corp.	6,217,361
		16,128,486
	MACHINERY-DIVERSIFIED (6.2%)	
176,900	Daifuku Co., Ltd.	4,557,814
325,000	Ebara Corp.	6,249,827
		10,807,641
	MISCELLANEOUS MANUFACTURERS (1.7%)	
212,600	Towa Corp.	2,965,451
	SEMICONDUCTORS (12.1%)	
86,900	Advantest Corp.	6,409,522
144,200	Kioxia Holdings Corp.	2,498,495
109,200	Kokusai Electric Corp.	2,620,770
139,100	Micronics Japan Co., Ltd.	5,209,269
14,500	Tokyo Electron, Ltd.	2,778,347
44,400	Ulvac, Inc.	1,630,807
		21,147,210
	TEXTILES (3.2%)	
131,500	Nitto Boseki Co., Ltd.	5,534,543
	TOTAL JAPAN (Cost \$60,172,561)	68,458,905
	MALAYSIA (3.8%)	
	ELECTRONICS (1.8%)	
7,808,500	Nationgate Holdings Bhd.	3,039,625
	ENGINEERING & CONSTRUCTION (1.0%)	
1,925,400	Frontken Corp. Bhd.	1,809,775
	METAL FABRICATE/HARDWARE (0.5%)	
2,010,000	UWC Bhd.	911,251
	SEMICONDUCTORS (0.5%)	
1,727,200	Inari Amertron Bhd.	828,138
	TOTAL MALAYSIA (Cost \$7,961,989)	6,588,789
	SOUTH KOREA (5.2%)	
	SEMICONDUCTORS (5.2%)	
44,226	LEENO Industrial, Inc.	1,667,608
23,802	SK Hynix, Inc.	5,148,666
91,340	TechWing, Inc.	2,256,603
		9,072,877
	TOTAL SOUTH KOREA (Cost \$7,846,224)	9,072,877
	TAIWAN (44.2%)	
	BUILDING MATERIALS (1.8%)	
282,000	Kinik Co.	3,093,439
	CHEMICALS (1.7%)	
93,000	Allied Supreme Corp.	800,544
1,136,000	Solar Applied Materials Technology Corp.	2,111,264
		2,911,808
	COMPUTERS (5.0%)	
113,000	AURAS Technology Co., Ltd.	2,479,139
218,000	Bizlink Holding, Inc.	6,327,275
		8,806,414
	ELECTRONICS (8.7%)	
317,000	Gold Circuit Electronics Ltd.	3,200,705
105,000	Jentech Precision Industrial Co., Ltd.	5,426,635
31,000	Lotes Co., Ltd.	1,432,385
667,000	Unimicron Technology Corp.	2,602,526
156,000	Yageo Corp.	2,589,588
		15,251,839

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Next Generation Semiconductor Asia Fund
Schedule of Investments (continued)
As of June 30, 2025

(Expressed in United States Dollars)

<u>Shares</u>	<u>Security Description</u>	<u>% of Net Assets</u>	<u>Fair Value</u>
	COMMON STOCKS (97.0%) (continued)		
	TAIWAN (44.2%) (continued)		
	ENGINEERING & CONSTRUCTION (1.5%)		
63,000	Acter Group Corp., Ltd.		\$ 857,121
165,000	L&K Engineering Co. Ltd.		1,730,927
			2,588,048
	MISCELLANEOUS MANUFACTURERS (0.5%)		
29,000	Elite Material Co., Ltd.		875,449
	SEMICONDUCTORS (25.0%)		
33,000	Atchip Technologies, Ltd.		3,495,739
52,000	ASMedia Technology, Inc.		3,399,391
35,000	ASPEED Technology, Inc.		5,684,191
132,000	Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.		3,781,497
55,000	eMemory Technology, Inc.		4,442,619
156,000	Global Unichip Corp.		6,967,861
128,957	Himax Technologies, Inc. - ADR		1,151,586
68,000	M31 Technology Corp.		1,221,891
10,000	MediaTek, Inc.		427,833
983,000	Nanya Technology Corp.		1,722,614
224,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.		8,126,776
63,000	WinWay Technology Co. Ltd.		2,792,381
			43,214,379
	TOTAL TAIWAN (Cost \$68,741,623)		76,741,376
	THAILAND (2.0%)		
	MISCELLANEOUS MANUFACTURERS (2.0%)		
11,763	Fabrinet		3,466,321
	TOTAL THAILAND (Cost \$2,642,745)		3,466,321
	UNITED STATES (1.5%)		
	SEMICONDUCTORS (1.5%)		
704,000	GCS Holdings, Inc.		2,626,416
	TOTAL UNITED STATES (Cost \$2,393,145)		2,626,416
	TOTAL COMMON STOCKS (Cost \$151,448,896)		168,589,626
<u>Principal Amount</u>	<u>Security Description</u>		
	SHORT-TERM INVESTMENTS (2.1%)		
	TIME DEPOSIT (2.1%)		
	HONG KONG (0.0%)*		
HKD 179	ANZ National Bank		23
	0.02% due 07/02/2025		23
	TOTAL HONG KONG (Cost \$23)		23
	UNITED KINGDOM (0.1%)		
JPY 18,448,784	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd.		127,709
	0.12% due 07/01/2025		127,709
	TOTAL UNITED KINGDOM (Cost \$127,709)		127,709
	UNITED STATES (2.0%)		
USD 3,577,334	JPMorgan Chase & Co.		3,577,334
	3.58% due 07/01/2025		3,577,334
	TOTAL UNITED STATES (Cost \$3,577,334)		3,577,334
	TOTAL TIME DEPOSIT (Cost \$3,705,066)		3,705,066
	TOTAL SHORT-TERM INVESTMENTS (Cost \$3,705,066)		3,705,066
	TOTAL INVESTMENTS (Cost \$155,153,962)	99.1%	\$ 172,294,692
	CASH AND OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES	0.9%	1,539,116
	NET ASSETS	100.0%	\$ 173,833,808

* A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than 0.05%.

PORTFOLIO ABBREVIATIONS

ADR	American Depositary Receipt
HKD	Hong Kong Dollar
JPY	Japanese Yen
USD	United States Dollar

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

マネー・リクイディティ・マザーファンド
第16期 運用状況のご報告
決算日：2026年7月17日

当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。
主要投資対象	わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式および外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率	債組入比率	債券先物比率	純資産総額
12期(2022年7月19日)	円 9,998	% △0.1	% 80.0	% —	百万円 329
13期(2023年7月18日)	9,992	△0.1	87.8	—	254
14期(2024年7月17日)	9,990	△0.0	81.9	—	303
15期(2025年7月17日)	10,018	0.3	65.1	—	353
16期(2026年7月17日)	10,078	0.6	69.3	—	446

(注) 基準価額は1万円当たり。

(注) 当ファンドは、特定の指数を上回るまたは連動する成果を目指した運用を行っておりません。そのため、特定のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

(注) 債券先物比率＝買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

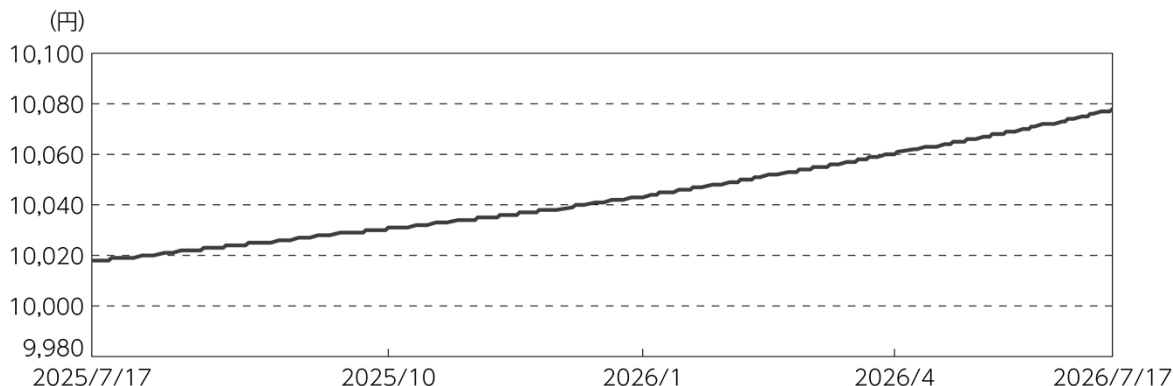
年月日	基準価額	騰落率	債組入比率	債券先物比率
(期首) 2025年7月17日	円 10,018	% —	% 65.1	% —
7月末	10,019	0.0	73.7	—
8月末	10,023	0.0	56.7	—
9月末	10,027	0.1	63.4	—
10月末	10,031	0.1	64.7	—
11月末	10,034	0.2	55.0	—
12月末	10,038	0.2	61.7	—
2026年1月末	10,043	0.2	64.5	—
2月末	10,048	0.3	53.0	—
3月末	10,054	0.4	60.5	—
4月末	10,060	0.4	72.0	—
5月末	10,066	0.5	70.3	—
6月末	10,073	0.5	58.2	—
(期末) 2026年7月17日	10,078	0.6	69.3	—

(注) 騰落率は期首比。

運用経過

期中の基準価額等の推移

(2025年7月18日～2026年7月17日)



○基準価額の主な変動要因

当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・保有債券の利息収入を獲得したことがプラスに寄与しました。

(主なマイナス要因)

- ・特にありません。

投資環境

(2025年7月18日～2026年7月17日)

国内短期金融市場では、2025年12月の日銀による利上げや、2026年1月には高市首相が衆議院を解散したことなどを受け、2月にかけて1年国債利回りは大きく上昇しました。2月末以降は、米国とイスラエルによるイランへの軍事行動を背景に原油価格が急騰し、国内のインフレ懸念が強まったことや、7月上旬には経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）を巡る財政拡張や日銀のインフレ対応が後手に回るとの見方が意識されたことから利回りは一段と上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

(2025年7月18日～2026年7月17日)

わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とした運用を行いました。当期間中は、国債および政府保証債を組み入れました。

今後の運用方針

(投資環境の見通し)

国内短期金融市場は、日銀による追加利上げ観測が残ることから、1年国債利回りに上昇圧力が掛かる展開を想定しています。

(運用方針)

わが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益確保を目的に運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2025年7月18日～2026年7月17日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2025年7月18日～2026年7月17日)

公社債

		買付額	売付額
国	国債証券	千円 1,043,079	千円 — (800,000)
	特殊債券	—	— (165,000)

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) 単位未満は切捨て。

(注) () 内は償還等による増減分です。

○利害関係人との取引状況等

(2025年7月18日～2026年7月17日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2026年 7 月17日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	310,000	309,480	69.3	—	—	—	69.3
	(310,000)	(309,480)	(69.3)	(—)	(—)	(—)	(69.3)
合 計	310,000	309,480	69.3	—	—	—	69.3
	(310,000)	(309,480)	(69.3)	(—)	(—)	(—)	(69.3)

(注) () 内は非上場債券で内書きです。
(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
(注) 額面・評価額の単位未満は切捨て。
(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第1319回国庫短期証券	—	25,000	24,997	2026/ 7 /21
第1326回国庫短期証券	—	30,000	29,976	2026/ 8 /20
第1332回国庫短期証券	—	40,000	39,929	2026/ 9 /24
第1373回国庫短期証券	—	35,000	34,920	2026/10/13
第1377回国庫短期証券	—	30,000	29,993	2026/ 7 /27
第1379回国庫短期証券	—	40,000	39,876	2026/11/10
第1380回国庫短期証券	—	40,000	39,977	2026/ 8 /10
第1384回国庫短期証券	—	30,000	29,966	2026/ 8 /31
第1386回国庫短期証券	—	40,000	39,843	2026/12/10
合 計		310,000	309,480	

(注) 額面・評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年 7 月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円	%
	309,480	69.3
コール・ローン等、その他	137,178	30.7
投資信託財産総額	446,658	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年7月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	446,658,239
コール・ローン等	137,174,392
公社債(評価額)	309,480,585
未収利息	3,262
(B) 負債	0
(C) 純資産総額(A－B)	446,658,239
元本	443,220,124
次期繰越損益金	3,438,115
(D) 受益権総口数	443,220,124口
1万口当たり基準価額(C／D)	10,078円

(注) 計算期間末における1口当たりの純資産額は、1.0078円です。

(注) 当ファンドの期首元本額は352,380,206円、期中追加設定元本額は258,879,356円、期中一部解約元本額は168,039,438円です。

(注) 当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、以下の通りです。

次世代A I 株式戦略ファンド
139,791,743円

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし)
127,927,643円

アジア半導体関連フォーカスファンド(愛称 ライジング・セミコン・アジア)
58,727,627円

シン・インド割安成長株ファンド
39,612,998円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)ユーロコース
30,288,124円

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型)
19,105,636円

オール・カンントリー好配当リバランスオープン(資産成長型)
8,412,833円

米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)
6,587,790円

欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型)円コース
5,686,993円

高成長ASEAN小型株式ファンド
4,162,896円

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース
2,163,911円

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース
751,930円

○損益の状況 (2025年7月18日～2026年7月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,466,576
受取利息	2,466,576
(B) 有価証券売買損益	38,671
売買益	38,671
(C) 当期損益金(A＋B)	2,505,247
(D) 前期繰越損益金	622,786
(E) 追加信託差損益金	1,120,644
(F) 解約差損益金	△ 810,562
(G) 計(C＋D＋E＋F)	3,438,115
次期繰越損益金(G)	3,438,115

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

＜お知らせ＞

・一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併継続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款の記載変更を行いました。(実施日：2026年4月1日)